(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2004 年9 月16 日 (16.09.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/079454 A1

(51) 国際特許分類[7]: G03F 7/075, 7/004, C08F 8/00, 290/12

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/002732

(22) 国際出願日: 2004 年3 月4 日 (04.03.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-061813 2003 年3 月7 日 (07.03.2003) JP
特願 2003-385222
2003 年11 月14 日 (14.11.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭硝子株式会社 (ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒1008405 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高橋 秀幸 (TAKAHASHI, Hideyuki) [JP/JP]; 〒2218755 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１１５０番地 旭硝子株式会社内 Kanagawa (JP). 石関 健二 (ISHIZEKI, Kenji) [JP/JP]; 〒2218755 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１１５０番地 旭硝子株式会社内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 泉名 謙治, 外 (SENMYO, Kenji et al.); 〒1010042 東京都千代田区神田東松下町３８番地 鳥本鋼業ビル Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND CURED COATING FILM

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物及びその塗膜硬化物

(57) Abstract: A photosensitive resin composition which comprises a resin (A1) having a group containing a fluorine atom, a group containing a silicon atom and an ethylenic double bond, a radical initiator (B) and an alkali-soluble photosensitive resin (D) having three or more ethylenic double bonds in a molecule; and a photosensitive resin composition which comprises a resin (A2) having a group containing a fluorine atom and an ethylenic double bond, a resin (A3) having a group containing a silicon atom and an ethylenic double bond, a radical initiator (B) and an alkali-soluble photosensitive resin (D) having three or more ethylenic double bonds in a molecule.

(57) 要約: フッ素原子含有基とケイ素原子含有基とエチレン性二重結合とを含む樹脂（Ａ１）と、ラジカル開始剤（Ｂ）と、分子内に３個以上のエチレン性二重結合を有するアルカリ可溶の感光性樹脂（Ｄ）とを含む感光性樹脂組成物。また、フッ素原子含有基とエチレン性二重結合とを含む樹脂（Ａ２）と、ケイ素原子含有基とエチレン性二重結合とを含む樹脂（Ａ３）と、ラジカル開始剤（Ｂ）と、分子内に３個以上のエチレン性二重結合を有するアルカリ可溶の感光性樹脂（Ｄ）とを含む感光性樹脂組成物。

WO 2004/079454 A1